

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004 年1 月29 日 (29.01.2004)

PCT

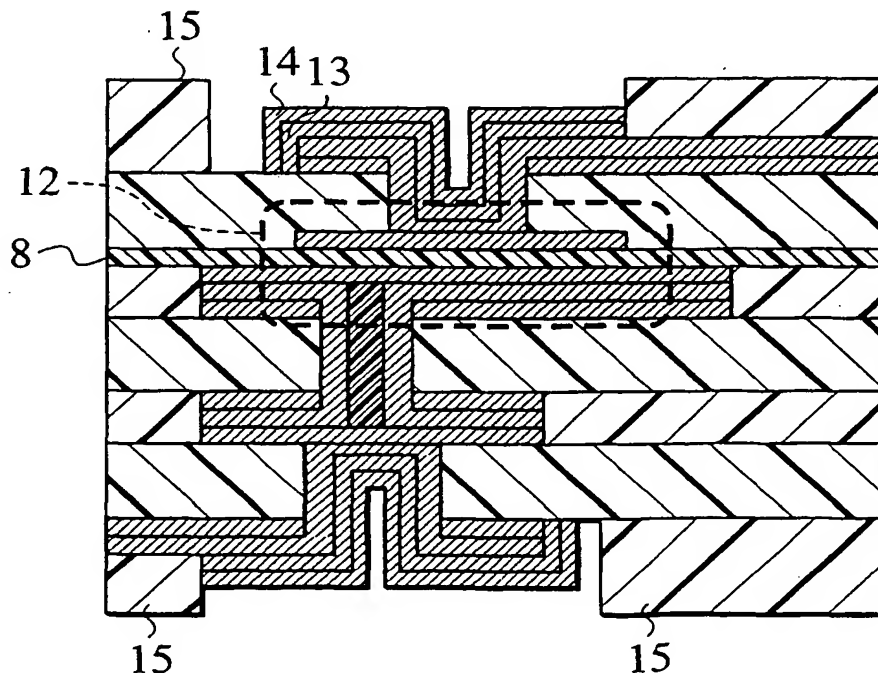
(10) 国際公開番号
WO 2004/010751 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H05K 1/16, [JP/JP]; 〒163-0449 東京都 新宿区 西新宿二丁目1番1号 Tokyo (JP).
3/46, H01F 17/00, H01G 4/40, 4/18
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/006860 (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 島田 靖 (SHI-MADA, Yasushi) [JP/JP]; 〒308-8521 茨城県 下館市 大字小川1500番地 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP). 平田 善毅 (HIRATA, Yoshitaka) [JP/JP]; 〒308-8521 茨城県 下館市 大字小川1500番地 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP). 栗谷 弘之 (KURIYA, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒163-0449 東京都 新宿区 西新宿二丁目1番1号 日立化成工業株式会社内 Tokyo (JP). 大塚 和久 (OTSUKA, Kazuhisa) [JP/JP]; 〒308-8521 茨城県 下館市 大字小川1500番地 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP). 山口 正憲 (YAMAGUCHI, Masanori) [JP/JP]; 〒308-8521 茨城県 下館市 大字小川1500番地 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP). 島山 裕一 (SHI-MAYAMA, Yuichi) [JP/JP]; 〒308-8521 茨城県 下館市
- (22) 国際出願日: 2003 年5 月30 日 (30.05.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2002-209650 2002 年7 月18 日 (18.07.2002) JP
特願2002-209639 2002 年7 月18 日 (18.07.2002) JP
特願2002-259291 2002 年9 月4 日 (04.09.2002) JP
特願2002-259284 2002 年9 月4 日 (04.09.2002) JP
特願2002-324238 2002 年11 月7 日 (07.11.2002) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.)

[続葉有]
CONTINUE...

(54) Title: MULTILAYER WIRING BOARD, METHOD FOR PRODUCING THE SAME, SEMICONDUCTOR DEVICE AND RADIO ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称: 多層配線板、およびその製造方法、ならびに半導体装置および無線電子装置



(57) Abstract: A multilayer wiring board exhibiting excellent moldability and having a capacitor where variation of capacitance is suppressed, its producing method, a semiconductor device mounting a semiconductor chip on the multilayer wiring board, and a radio electronic device mounting the semiconductor device.

[続葉有]
CONTINUE...



大字小川1500番地 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP). 斑目 健 (MADARAME, Ken) [JP/JP]; 〒308-8521 茨城県 下館市 大字小川1500番地 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP). 水嶋 悦男 (MIZUSHIMA, Etsuo) [JP/JP]; 〒308-8521 茨城県 下館市 大字小川1500番地 日立化成工業株式会社 下館事業所内 Ibaraki (JP). 近藤 裕介 (KONDOU, Yuusuke) [JP/JP]; 〒308-8521 茨城県 下館市 大字小川1500番地 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP). 山本 和徳 (YAMAMOTO, Kazunori) [JP/JP]; 〒308-8521 茨城県 下館市 大字小川1500番地 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP).

(74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒105-0001 東京都 港区 虎ノ門一丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,

LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 補正書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 本発明は、容量ばらつきが小さなコンデンサを有し、かつ成型性の優れた多層配線板、該多層配線板の製造方法、該多層配線板に半導体チップを搭載した半導体装置、および該半導体装置を搭載した無線電子装置を提供する。